

『先端実装材料・技術の最新動向』

(一社)エレクトロニクス実装学会関西支部では、「先端実装材料・技術の最新動向」と題するテーマで第16回技術講演会を開催致します。本講演会では、実装に関わる材料、技術等について、著名な講師に専門的な立場でご講演頂きます。また、講演会に続き、各講演者と参加者がフリーディスカッションできるテクノロジーマッチングセッションを実施致します。本技術講演会を通じて、次の開発やビジネスのきっかけにさせていただくとともに、業界の人脈形成の機会になればと考えます。多くの方々のご参加をお待ちしております。

・日時:2020年2月20日(木) 10:30~17:00 (テクノロジーマッチングセッション 17:20~19:00)

・会場:大阪府立大学 I-site なんば 2階 C2,C3室

〒556-0012 大阪市浪速区敷津東2丁目1番41号 南海なんば第一ビル2、3階

Tel:06-7656-0441(代表)

・主催:エレクトロニクス実装学会 関西支部

・協賛:日本電子回路工業会(JPCA)、表面技術協会関西支部、応用物理学会関西支部、高分子学会関西支部、電気学会関西支部、日本接着学会関西支部、スマートプロセス学会エレクトロニクス生産科学部会、近畿化学協会エレクトロニクス部、日本繊維機械学会、化学工学会エレクトロニクス部会、大阪府立大学 ものづくりイノベーション研究所、電子情報通信学会電子部品・材料研究専門委員会(含予定)

プログラム

・10:00-10:30 受付

・10:30-10:35 開会挨拶・オリエンテーション

・10:35-11:15 招待講演1 「CASE・MaaS時代を支える電動船用パワーモジュールの実装技術」 トヨタ自動車 門口 卓矢氏

・11:15-11:55 招待講演2 「スマートテキスタイルの技術要素と世界の開発動向」 福井大学 堀 照夫氏

・11:55-12:55 昼食休憩

・12:55-13:35 招待講演3 「ウェアラブルとin vitro計測に向けた生体調和エレクトロニクス」 東京大学 李 成薫氏

・13:35-13:55 技術講演1 「シクロデキストリンを用いた自己修復材料のご紹介」 ダイキン工業株式会社 平賀 健太郎氏

・13:55-14:15 技術講演2 「常温接合技術 シリコンウエハー、ガラス、高分子、金属箔等の有機系接着剤も熱も使用しない接合方法」
ランテクニカルサービス株式会社 松本好家氏

・14:15-14:25 休憩

・14:25-14:45 技術講演3 「ブロックコポリマーを用いた熱硬化性樹脂の新しい韌性改質アプローチ」
アルケマ株式会社 有浦 英美氏

・14:45-15:05 技術講演4 「プラスチックレンズに高効率微小太陽電池セルを実装した薄型・軽量集光型太陽電池」
パナソニック株式会社 林 信彦氏

・15:05-15:25 技術講演5 「(仮) 高速スパッタリング装置」 株式会社島津製作所 山下 拓也氏

・15:25-15:35 休憩

・15:35-15:55 技術講演6 「(仮)コオロギのプロテインバー」 株式会社BuGMo 松居 佑典氏

・15:55-16:15 技術講演7 「内容調整中」 三菱ケミカル株式会社 担当調整中

・16:15-16:55 招待講演4 「(仮)車載向け封止樹脂」 住友ベークライト株式会社 松尾 誠氏

・16:55-17:00 閉会挨拶

・17:00-17:20 休憩・セッション会場に移動

・17:20-19:00 テクノロジーマッチングセッション

アルコールと食事をしながら、参加者・講演者がフリートーク形式で語り合ってください。

・19:00-19:05:閉会

* 定員 70名(先着申込順)

* 参加費「クーポン利用可:1名/枚」

会員/賛助会員/協賛学会会員:11,000円 非会員:16,000円 学生会員:1,000円 一般学生:3,000円
・税込、テクノロジーマッチングセッション費込。参加申込み受付後、振込先をお知らせします。

* 申し込み締め切り:2020年2月13日(木)

・ご参加の方は関西支部 HP(<https://web.jiep.or.jp/kansai/index.html>)の参加申し込みフォームからご登録ください。(1月受付開始予定)。

・この機にエレクトロニクス実装学会への入会を希望される方は、その旨明記の上お申込み下さい。

問合せ先:エレクトロニクス実装学会関西支部事務局 info-kansai(*)jiep.or.jp (*)を@にして送付ください。